# Методы управления длиной волны излучения в гетероструктурах InAs/GaAsN/InGaAsN на подложках GaAs

© В.В. Мамутин<sup>¶</sup>, А.Ю. Егоров<sup>\*</sup>, Н.В. Крыжановская<sup>\*</sup>, В.С. Михрин, А.М. Надточий, Е.В. Пирогов<sup>\*</sup>

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,

194021 Санкт-Петербург, Россия

\* Санкт-Петербургский физико-технологический научно-образовательный центр Российской академии наук,

194021 Санкт-Петербург, Россия

(Получена 6 ноября 2007 г. Принята к печати 19 ноября 2007 г.)

Проведен обзор исследований свойств соединения InGaAsN и методов управления длиной волны излучения в гетероструктурах InAs/GaAsN/InGaAsN, выращенных молекулярно-пучковой эпитаксией на подложках GaAs. Представлены результаты исследований различных типов гетероструктур с квантово-размерными слоями InGaAsN: 1) традиционные квантовые ямы InGaAsN в матрице GaAs, 2) квантовые точки InAs, помещенные в слой (In)GaAsN, 3) напряженно-компенсированные сверхрешетки InAs/GaAsN/InGaAsN с квантовыми ямами и квантовыми точками. Примененные методы позволяют управляемо изменять длину волны излучения в телекоммуникационном диапазоне от 1.3 до 1.76 мкм при комнатной температуре.

PACS: 42.55.Px, 73.21.Cd, 73.21.Fg, 73.21.La, 73.40.Kp, 78.55.-m, 78.67.Pt

## 1. Введение

В настоящее время усилия многих исследований сосредоточены на создании эффективных излучателей в диапазоне длин волн 1.3-1.55 мкм, соответствующем окнам прозрачности оптического волокна, альтернативных существующим на рынке лазерам на основе InP. Одной из таких альтернатив получения излучения в диапазоне длин волн 1.3-1.55 мкм на основе подложек GaAs является соединение InGaAsN. При добавлении азота в GaAs происходит уникально сильное уменьшение ширины запрещенной зоны твердого раствора, необычное для соединений А<sup>III</sup>В<sup>V</sup> (180 мэВ при концентрации азота только 1% [1]). Добавление In в твердый раствор GaAsN приводит к компенсации сжатия решетки, вызванного азотом, и к еще большему уменьшению ширины запрещенной зоны. Таким образом, с помощью соединения InGaAsN возможно получить слои, близкие по постоянной решетки к GaAs и излучающие в ближнем инфракрасном диапазоне 1.3-1.55 мкм. В качестве основных преимуществ использованных в лазерах соединений InGaAsN, выращенных на подложках GaAs, по сравнению с распространенными в настоящее время гетероструктурами InGaAs/InGaAsP, InGaAsP/InP можно перечислить следующие: лучшая температурная стабильность характеристик лазеров вследствие увеличения разрывов зон и, как следствие, энергии локализации носителей в активной области; возможность создания поверхностно излучающих лазеров с монолитными брэгговскими зеркалами AlGaAs/GaAs, более высокая теплопроводность слоев структур.

Однако с увеличением длины волны излучения до 1.55 мкм, что требует большего содержания индия и азота, вследствие ухудшения структурных свойств активной области InGaAsN наблюдается резкое возрастание пороговых токов инжекционных лазеров и падение эффективности излучения [2]. Поэтому особенный интерес представляет исследование свойств гетероструктур InGaAsN/GaAs, а также создание и применение их различных дизайнов, с помощью которых возможно улучшить характеристики излучателей, работающих в области 1.3–1.55 мкм.

Данная статья посвящена обзору исследований свойств соединений InGaAsN и различных методов управления длиной волны излучения в гетеро-(ГС) InAs/InGaAsN/GaAs, выращенных структурах молекулярно-пучковой эпитаксией. Представлены результаты исследований различных типов гетероструктур с квантово-размерными слоями InGaAsN: 1) традиционные квантовые ямы InGaAsN в матрице GaAs, 2) квантовые точки InAs, помещенные в слой (In)GaAsN, 3) гетероструктуры InAs/GaAs/InGaAsN с напряженно-компенсированными сверхрешетками (НКСР) с квантовыми ямами (КЯ) и квантовыми точками (КТ), излучающими в области от 1.3 до 1.76 мкм при комнатной температуре.

## 2. Эксперимент

Исследованные структуры выращивались методом молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ) на подложках GaAs (001) на установках ЭП-1203 (Россия) и RIBER-32 (Франция) с плазменным источником азота с радиочастотным разрядом (Applied Epi UNI-bulb RF Plasma Source). Температура подложки при росте азотсодержащих слоев находилась в области  $350-370^{\circ}$ С. Остальная часть структуры выращивалась при  $500-600^{\circ}$ С. Активные области осаждались в середину волноводного слоя GaAs, ограниченного со стороны подложки и поверхности барьерами  $Al_{0.3}$ Ga<sub>0.7</sub>As. После роста

<sup>¶</sup> E-mail: mamutin@mail.ru

верхнего слоя  $Al_{0.3}Ga_{0.7}As$  проводился отжиг структуры в течение ~ 5 мин в потоке мышьяка при температуре около 700°С. Планарность и качество слоев во время роста контролировались системой дифракции быстрых электронов [3].

Для исследования свойств квантово-размерных слоев InGaAsN были выращены структуры, в которых варьировалось содержание In и N в диапазонах 0.25-0.41 и 0-0.05 мольных долей соответственно. Гетероструктуры с квантовыми точками InAs/GaAs выращивались по механизму роста Странски–Крастанова. Квантовые точки InAs либо осаждались в слой GaAsN толщиной 0-100 нм и мольной долей азота 0-0.025, либо заращивались слоем InGaAs(N) с концентрацией азота 0-0.02 [3].

Для исследования возможности смещения излучения квантовой ямы InGaAsN в длинноволновую сторону с помощью короткопериодной сверхрешетки GaAsN/InGaAsN были выращены структуры, в которых KЯ InGaAsN помещалась в сверхрешетку, состоящую из слоев GaAs<sub>0.96</sub>N<sub>0.04</sub>/In<sub>0.38</sub>Ga<sub>0.62</sub>As<sub>0.974</sub>N<sub>0.026</sub>. Толщина слоя GaAs<sub>0.96</sub>N<sub>0.04</sub> варьировалась в диапазоне 1.0-2.0 нм, а толщина слоя In<sub>0.38</sub>Ga<sub>0.62</sub>As<sub>0.974</sub>N<sub>0.026</sub> — в диапазоне 0.5-1.0 нм. Количество слоев сверхрешетки изменялось от 10 до 30. Для дальнейшего увеличения длины волны излучения было предложено дополнительно в середину квантовой ямы InGaAsN поместить слой InAs толщиной порядка одного монослоя. Общая толщина КЯ InGaAsN в структурах составляла 6.8 нм и не превышала критической.

Фотолюминесценция (ФЛ) структур возбуждалась Ar<sup>+</sup>-лазером, работающим в непрерывном режиме ( $W = 1-1500 \text{ Bt/cm}^2$ ,  $\lambda = 514 \text{ нм}$ ), или лазером YAG : Nd, работающим на второй гармонике в непрерывном режиме ( $W = 1500 \text{ Bt/cm}^2$ ,  $\lambda = 532 \text{ нм}$ ).

#### 3. Основная часть

#### 3.1. Физические свойства твердого раствора InGaAsN

Уникальные физические свойства соединений  $A^{III}B^VN$  обусловлены химическими свойствами азота. Из-за большого различия в постоянных решетки (In)GaAs и GaN (более 20%) существует зона несмешиваемости этих двух материалов, что приводит к трудности синтеза слоев  $In_yGa_{1-y}As_{1-x}N_x$  и ухудшению их кристаллических свойств с формированием различных кластеров типа: (In)GaN, (In)GaAs, GaAsN при x > 0.10 [4]. Поэтому большинство публикаций рассматривает области составов  $In_yGa_{1-y}As_{1-x}N_x$  при x < 0.10.

**3.1.1. Ширина запрещенной зоны твердого** *раствора* **InGaAsN.** Получение твердых растворов A<sup>III</sup>B<sup>V</sup>N было мотивировано возможностью связать между собой арсенидные и нитридные соединения и тем

самым создать излучатели на основе прямозонных материалов А<sup>ШВV</sup>, полностью перекрывающие видимый диапазон длин волн. Соединение GaAsN действительно продемонстрировало свойства прямозонного материала. Однако, как показали еще первые эксперименты, край поглощения GaAsN смещался в сторону меньших, а не больших энергий фотона с увеличением концентрации азота [1], и ширина запрещенной зоны не увеличивалась, а уменьшалась. Сильный прогиб в зависимости ширины запрещенной зоны GaAsN от состава объясняется высоким значением электроотрицательности атомов азота [5]. В работе [6] была предложена модель антипересечения зон (Band Anticrossing (BAC) Model), которая позволяет описать изменение ширины запрещеннной зоны от состава по азоту в слоях (In)GaAsN. В этой модели рассматривается взаимодействие локализованного азотного уровня с зоной проводимости, в результате которого происходит расщепление зоны проводимости на две подзоны Е<sub>+</sub> и Е<sub>-</sub>. В случае внедрения азота в слои In<sub>v</sub>Ga<sub>1-v</sub>As положение локализованного уровня азота при комнатной температуре описывается формулой

$$E_{\rm N}(y) = 1.65 - 0.4y(1 - y), \tag{1}$$

где *E*<sub>N</sub> — в эВ.

В предположении, что однородно расположенные атомы азота слабо взаимодействуют с делокализованными состояниями полупроводниковой матрицы, решение возмущенной задачи на нахождение собственных значений волновой функции частицы имеет следующий вид:

$$E_{\pm}(k) = \frac{E_{\rm N} + E_M(k) \pm \left\{ \left[ E_{\rm N} - E_M(k) \right]^2 + 4V_{\rm NM}^2 \right\}^{1/2}}{2}, \quad (2)$$

где  $E_M(k)$  — дисперсионная зависимость энергии дна зоны проводимости материала полупроводниковой матрицы,  $V_{\rm NM}$  — матричный элемент взаимодействия. Он может быть представлен как

$$V_{\rm NM} = C_{\rm NM} \, x^{1/2},\tag{3}$$

где x — концентрация азота в слое, а  $C_{\rm NM}$  — константа, описывающая связь между локализованными состояниями и состояниями матрицы.

Нами было проведено моделирование изменения ширины запрещенной зоны упругонапряженного слоя GaAsN с помощью методики, предложенной в [6], и учтено влияние напряжений в эпитаксиальном слое GaAsN на положение энергетических зон (дна зоны проводимости и потолка валентной зоны) с помощью модели, предложенной в [7]. Вычисления выполнялись в приближении линейной зависимости постоянных упругости и постоянной решетки от состава. При расчете использовались следующие значения постоянных упругости GaAs:

$$c_{11} = 1.19 \cdot 10^{12}$$
 дин/см<sup>2</sup>,  $c_{12} = 0.534 \cdot 10^{12}$  дин/см<sup>2</sup>,



**Рис. 1.** Ширина запрещенной зоны слоев GaAsN, полученная с помощью модели антипересекающихся зон с учетом когерентных напряжений в слое (сплошная линия), и экспериментальные значения, полученные: *I* — из положений максимумов фотолюминесценции, *2* — из спектров поглощения в зависимости от концентрации азота.

гидростатического деформационного потенциала:

$$a_{\rm c} = -7.17$$
 эВ и  $a_{\rm v} = 1.16$  эВ,

деформационного потенциала сдвига b = -1.7 эВ, ширины запрещенной зоны E = 1.42 эВ, постоянной решетки a = 5.653 Å, сдвига усредненной энергии валентной зоны  $E_{\text{Vav}} = -6.92$  эВ. Значение коэффициента  $C_{\text{NM}}$  оказалось равным 2.7 эВ, что согласуется с опубликованными данными [6].

Полученная зависимость ширины запрещенной зоны слоев GaAsN, осажденных на подложку GaAs, полученная с помощью модели антипересечения зон с учетом когерентных напряжений в слое, приведена на рис. 1 (сплошная линия). Также на рис. 1 представлены экспериментальные значения, полученные из положений максимумов фотолюминесценции (1), и значения ширины запрещенной зоны, полученные из спектров поглощения (2), для слоев GaAsN различного состава.

**3.1.2.** Структура валентной зоны твердого раствора InGaAsN. В работах [8–11] было показано, что большое различие параметров кристаллической решетки слоев GaAsN и подложки GaAs приводит к возникновению напряжения в слоях GaAsN. В результате происходит изменение положения краев зоны проводимости и валентной зоны и расщепление энергетических уровней валентной зоны. Существуют различные теоретические модели, описывающие поведение края валентной зоны соединений GaAsN [10,12,13]. В работе [14] было показано, что критическая толщина слоев GaAsN значительно превышает величину, которую можно получить исходя из модели Мэтьюса и Блексли [15]. Поэтому большинство имеющихся слоев GaAsN являются упругонапря-

раев зоны проводимости и **3.1.4. Оптические свойства твердых растворов** ие энергетических уровней (In)GaAsN. Так как основной областью применения

(In)GaAsN. Так как основной областью применения соединения (In)GaAsN является оптоэлектроника, наибольшая часть опубликованных работ посвящена улучшению оптических свойств соединения и определению основного механизма излучательной рекомбинации. Форма спектра фотолюминесценции слоев (In)GaAsN асимметрична: высокоэнергетичный край описывает распределение носителей по температуре, в то время

Физика и техника полупроводников, 2008, том 42, вып. 7

женными и испытывают биаксиальное напряжение растяжения. Это приводит к расщеплению уровней легкой и тяжелой дырок, так что верхней валентной зоной оказыается зона легких дырок. В работе [16] на основе проведенных измерений спектров электроотражения от слоев GaAs<sub>1-x</sub>N<sub>x</sub>/GaAs и полученных данных об энергии расщепления подзон валентной зоны показано, что потенциал деформации для валентной зоны имеет нелинейный характер от содержания азота x. При этом считалось, что постоянные упругости не зависят от состава.

3.1.3. Кристаллическая решетка твердых рас**творов** InGaAsN. Отклонение от линейного закона для постоянных упругости и постоянной решетки описано в [17,18]. В этих работах исследованы слои  $GaAs_{1-x}N_x/GaAs$  различного состава (0 < x < 0.03) с использованием методов вторичной ионной массспектроскопии (SIMS) и дифракции рентгеновских лучей для получения кривых качания с целью определения концентрации азота в слоях. Оказалось, что вычисление концентрации азота в слоях  $GaAs_{1-x}N_x$  для x > 0.015 из результатов рентгеновской дифрактометрии в приближении линейной зависимости постоянных упругости дает заниженный результат по сравнению с данными вторичной ионной масс-спектроскопии. Другими словами, для концентраций азота x > 0.015 наблюдается отклонение постоянной решетки от закона Вегарда. В работе [17] было предложено следующе выражение для зависимости постоянной решетки GaAs<sub>1-x</sub>N<sub>x</sub> от концентрации азота х:

$$a_0 = a_{\text{GaAs}} - 1.0605x - 20.95x^2.$$

Авторы считают, что основной причиной такого отклонения является неидеальность твердого раствора GaAsN, а именно, существование межузельных комплексов N–As, N–N, образующихся вследствие большой разницы ковалентных радиусов атомов азота (0.075 нм), мышьяка (0.120 нм) и галлия (0.126 нм), а также низких температур осаждения материала.

Необходимо отметить, что добавление атомов In в GaAsN приводит к компенсации сжатия в решетке, индуцированного азотом. При линейной зависимости постоянной решетки от состава твердый раствор  $In_xGa_{1-x}N_yAs_{1-y}$  является решеточно-согласованным с GaAs для составов  $x \approx 2.5y$  [17].

как длинноволновый край полосы излучения имеет существенную экспоненциальную затяжку, отражающую распределение плотности состояний по энергии. Время затухания ФЛ изменяется при движении вдоль контура линии ФЛ для слоя GaAs<sub>0.78</sub>N<sub>0.028</sub> от 350 пс на коротковолновом краю до 4-8 нс на длинноволновом краю [4]. Увеличение мощности оптической накачки ведет к коротковолновому сдвигу максимума ФЛ. Температурная зависимость ФЛ также необычна. С увеличением температуры максимум ФЛ сначала сдвигается в сторону меньших энергий фотона, затем испытывает обратный ход в коротковолновую сторону и при температурах, обычно больших чем 140 К, опять двигается в сторону меньших энергий фотона (S-shaped), следуя зависимости ширины запрещенной зоны от температуры [19]. В работах [4,20] подобное поведение описывается с помощью рекомбинации носителей, локализованных на флуктуациях потенциала. Значение локализующего потенциала (40-60 мэВ) зависит от концентрации азота в слое и условий его получения и сильно превосходит флуктуации потенциала из-за неоднородности слоев GaAsP, AlGaAs (~1 мэВ). Основной причиной возникновения флуктуаций потенциала в InGaAsN-слоях считается неоднородность распределения атомов азота и индия и соответственно неоднородность распределения напряжений.

#### 3.2. Свойства гетероструктур на основе твердых растворов InGaAsN

**3.2.1.** Тип гетероперехода InGaAs/InGaAsN. Расположение краев зон в гетеропереходе InGaAsN/ GaAs исследовалось различными методами (оптическое поглощение,  $\Phi \Pi$ , поляризованное возбуждение  $\Phi \Pi$ ) [21–23]. Многочисленные исследования в широких диапазонах концентрации азота и индия показали, что в гетеропереходе InGaAsN/GaAs реализуется переход I рода.

Долгое время нерешенным оставался вопрос о взаимном расположении краев зон в гетеропереходах GaAs/GaAsN и InGaAs/GaAsN. Существовали различные теоретические модели, описывающие поведение края валентной зоны соединений GaAsN [8,12,13]. Так, согласно модели [12], на границе соединений GaAs/GaAsN образуется гетеропереход II рода, в то время как другие приведенные модели демонстрируют существование гетероперехода I рода. Очевидно, что информация о расположении краев зон в гетеропереходах GaAs/GaAsN и InGaAs/GaAsN очень важна при использовании подобных структур в области длин волн, используемых в работе оптоэлектронных устройств. При исследовании гетероструктур GaAs/GaAsN и  $In_xGa_{1-x}As/GaAs_{1-y}N_y$  в работе [8] нами было показано, что гетеропереход GaAs/GaAsN является гетеропереходом I рода, а гетеропереход  $In_xGa_{1-x}As/GaAs_{1-y}N_y$ может быть переходом I или II рода в зависимости от значений х и у. Недавно были проведены исследования ГС Ga<sub>0.77</sub>In<sub>0.23</sub>As/GaAs<sub>1-x</sub>N<sub>x</sub> с помощью спектроскопии с временны́м разрешением [24]. Так как пространственное перекрытие волновых функций электронов и дырок в случае гетероперехода I рода больше, чем в случае гетероперехода II рода, время затухания ФЛ должно быть меньше в случае гетероперехода I рода, чем в случае гетероперехода II рода. В результате исследований авторы работы показали, что тип гетероперехода In<sub>0.23</sub>Ga<sub>0.77</sub>As/GaAs<sub>1-x</sub>N<sub>x</sub> зависит от концентрации азота: для структур с x = 0.48% и 0.72% — I рода, что согласуется с нашими результатами. Эти заключения были подтверждены и последними работами [25,26].

3.2.2. Свойства квантово-размерных слоев InGaAsN в матрице GaAs. Стандартным способом сдвига длины волны излучения из квантово-размерных слоев InGaAsN выше 1.3 мкм является увеличение концентрации азота и индия и их толщина. Однако использование высоких концентраций Inи N. необходимых для получения излучения в области 1.55 мкм ([In] > 35%, [N] > 3%) или больших толщин слоев, приводит к ухудшению оптических и структурных свойств InGaAsN квантово-размерных слоев следующим причинам:

 формирование протяженных дефектов — дислокаций, обусловленное большим различием в постоянных решетки GaAs и слоя InGaAsN;

 — распад твердого раствора вследствие существования зоны несмешиваемости, возникновение неоднородностей по составу и неровностей гетерограниц;

— увеличение концентрации дефектов в твердом растворе из-за использования низких температур осаждения квантово-размерных слоев InGaAsN.



**Рис. 2.** Зависимость плотности порогового тока от длины волны излучения при 300 К для инжекционных лазеров полосковой геометрии на основе квантово-размерных слоев InGaAsN, полученных методами: *1* — MOCVD, *2* — MBE. Цифрами указаны номера ссылок в списке литературы.

Физика и техника полупроводников, 2008, том 42, вып. 7

827

Такое изменение свойств приводит к ухудшению характеристик лазеров для диапазона длин волн выше 1.3 мкм. На рис. 2 представлена зависимость плотности порогового тока от длины волны излучения для инжекционных лазеров полосковой геометрии на основе квантово-размерных слоев InGaAsN, полученных различными авторами [27–37] с помощью метода газофазной эпитаксии из металлорганических соединений (MOCVD) и метода молекулярно-пучковой эпитаксии (MBE). Наблюдаемое увеличение порогового тока с увеличением длины волны излучения связано с ухудшением качества структур, вызванного необходимостью использовать большие концентрации азота и индия.

3.2.3. Свойства структур с квантовыми точками InAs/InGaAs, осажденными в матрицу (In)GaAsN. Как видно, продвижение в сторону больших длин волн (~ 1.55 мкм) для рассмотренного выше типа гетероструктур на основе квантово-размерных слоев InGaAsN/GaAs затруднено вследствие принципиальных ограничений, налагаемых пределом псевдоморфного роста, фазовой сепарацией твердого раствора и особенностями роста InGaAsN. Новый способ реализации излучения в области больших длин волн излучения, вплоть до 1.55 мкм, был предложен нами в 2002 г. [3]. За основу в эксперименте были приняты квантовые точки InAs, помещенные в слой GaAs<sub>1-r</sub>N<sub>r</sub>. Структуры с КТ InAs в матрице GaAs излучали при комнатной температуре в области 1.3 мкм. Подход, позволяющий получить излучение на длине волны 1.3 мкм от КТ InAs, был предложен ранее и заключался в эффекте активированного изменения состава твердого раствора In<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>As в процессе заращивания им квантовых точек, полученных осаждением InAs эффективной толщиной 2.3 монослоя [38]. Осаждение КТ InAs в узкозонной матрице GaAs<sub>1-x</sub>N<sub>x</sub> позволило нам использовать технологию получения КТ InAs, излучающих на длине волны 1.3 мкм, для увеличения длины волны. Добавление азота в материал матрицы (GaAs) приводит к значительному уменьшению ширины ее запрещенной зоны и соответствующему увеличению длины волны фотолюминесценции КТ. При увеличении концентрации азота в материале матрицы до 2.5% максимум ФЛ КТ сдвигается до 1.50 мкм (рис. 3). В то же время увеличение содержания азота в матрице приводит к значительному падению интенсивности и увеличению полуширин линий ФЛ (FWHM) структур вследствие усиления роли безызлучательной рекомбинации из-за формирования дефектов в слое  $GaAs_{1-x}N_x$ , связанных с трудностями синтеза соединения GaAsN [39].

Поэтому нами был предложен второй цикл экспериментов [40], в котором добавление азота производилось не в материал матрицы, а в тонкий слой  $In_{0.15}Ga_{0.85}As$ , покрывающий массив КТ. Этот подход является более гибким, так как позволяет оперировать большим количеством параметров для варьирования длины волны излучения КТ: как толщина, так и состав покрывающего



**Рис. 3.** Спектры фотолюминесценции квантовых точек InAs/InGaAs, помещенных в слой GaAsN различного состава (указан около кривых), полученные при комнатной температуре. На вставке приведено схематическое изображение дна зоны проводимости в исследованных структурах.



Рис. 4. Спектры фотолюминесценции квантовых точек InAs, покрытых различными слоями при  $T \approx 300$  К: сплошная линия — In<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>As (5 нм), пунктирная линия — In<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>As (2 нм)/In<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>As<sub>0.976</sub>N<sub>0.024</sub> (3 нм), штриховая линия — In<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>As (1 нм)/In<sub>0.15</sub>Ga<sub>0.85</sub>As<sub>0.976</sub>N<sub>0.024</sub> (4 нм).

слоя  $In_yGa_{1-y}As_{1-x}N_x$ . С увеличинием толщины слоя  $In_{0.15}Ga_{0.85}As_{0.976}N_{0.024}$  от 0 до 4 нм наблюдается сдвиг длины волны максимума ФЛ КТ от 1.3 до 1.52 мкм (рис. 4). Тем не менее интенсивность фотолюминесценции таких структур значительно ниже интенсивности ФЛ КТ, покрытых только слоем  $In_{0.15}Ga_{0.85}As$  и излучающих в области 1.3 мкм (этот факт позволил нам ранее получить низкопороговые лазеры с длиной волны ~ 1.3 мкм при комнатной температуре [41,42]). Повидимому, такое снижение эффективности ФЛ связано с наличием сильных напряжений в слое  $In_yGa_{1-y}As_{1-x}N_x$ , приводящих к формированию дефектов в структуре.

3.2.4. Использование дополнительных слоев (In)GaAsN в структурах с квантовыми ямами InGaAsN/GaAs. В качестве другого способа уменьшения мольной доли азота в квантовой яме InGaAsN в работах [42,43] нами было предложено поместить этот слой в матрицу GaAsN, что позволило уменьшить высоту барьеров вокруг ямы. С помощью этого метода удалось увеличить длину волны до 1.41 мкм без ухудшения качества ФЛ и несколько улучшить эффективность ФЛ на длине волны 1.55 мкм. Тем не менее напряжения на гетерогранице GaAsN/InGaAsN приводят к ухудшению излучательных свойств гетероструктуры. Для решения этой проблемы в [44] вместо слоя GaAsN было предложено использовать слой твердого раствора In<sub>0 23</sub>Ga<sub>0 77</sub>As<sub>0 99</sub>N<sub>0 01</sub>. Увеличение эфективной толщины квантовой ямы и изменение ее эффективного состава позволило авторам получить излучение при комнатной температуре на длине волны 1.56 мкм.

3.2.5. Гетероструктуры InAs/GaAsN/InGaAsN с компенсацией напряжений. В 2004 г. нами был предложен новый метод получения эффективного излучения в области 1.55 мкм с помощью использования короткопериодной сверхрешетки GaAsN/InGaAsN, окружающей квантовую яму InGaAsN, в центр которой добавлен узкозонный слой InAs толщиной порядка 1 монослоя [45]. Этот метод позволяет уменьшить ширину запрещенной зоны матрицы и существенно понизить среднюю концентрацию азота и индия в активной области структуры, необходимую для получения излучения в области 1.55 мкм. Кроме того, использование сверхрешеток GaAsN/ InGaAsN [46], частично компенсирующих механическое напряжение, позволяет до некоторой степени подавить явления. нежелательные связанные с распалом сильно напряженного твердого раствора InGaNAs, и образование дислокаций и, как результат, повысить эффективность излучательной рекомбинации. Как было показано в работах [47,48], с помощью предложенного метода возможно управлять длиной волны излучения в широком диапазоне от 1.3 до 1.76 мкм ухудшения без существенного излучательных характеристик. Например, использование сверхрешетки  $GaAs_{0.96}N_{0.04}/In_{0.38}Ga_{0.62}As_{0.974}N_{0.026}$ позволяет, благодаря уменьшению потенциала барьера, сдвинуть длину волны излучения квантово-размерного слоя In<sub>0.38</sub>Ga<sub>0.62</sub>As<sub>0.974</sub>N<sub>0.026</sub> до 1.4 мкм без существенного ухудшения интенсивности ФЛ (структура 1 на рис. 5). Добавление тонкого слоя InAs (структура 2 на рис. 5) в центр квантово-размерного слоя In<sub>0.38</sub>Ga<sub>0.62</sub>As<sub>0.974</sub>N<sub>0.026</sub> приводит к сдвигу линии излучения до 1.49 мкм без падения интенсивности ФЛ. А увеличение чередующихся слоев GaAsN/InGaAsN окружающей сверхрешетки на одну пару с обеих сторон КЯ приводит к дальнейшему длинноволновому сдвигу до 1.50 мкм (структура 3 на рис. 5) [48].

Исследование влияния параметров напряженнокомпенсированных сверхрешеток на излучательные



**Рис. 5.** Спектры фотолюминесценции различных структур с напряженно-компенсированными сверхрешетками (см. вставки), полученные при комнатной температуре.



Рис. 6. Зависимости интегральной интенсивности фотолюминесценции от длины волны излучения при комнатной температуре для трех типов гетероструктур: *1* — квантовые ямы InGaAsN/GaAs, *2* — квантовые точки InAs/InGaAsN, *3* — сверхрешетки (SCSL) InAs/GaAsN/InGaAs.

свойства гетероструктур проведено в работе [49]. Было показано, что общие напряжения в структурах менялись от отрицательных (-0.3%) до положительных (+1.0%), что приводило соответственно к изменению длины волны от 1.42 до 1.66 мкм и увеличению полуширины линий ФЛ (FWHM) с 50 до 85 мэВ. Максимальная интенсивность ΦЛ наблюдалась В диапазоне от -0.3% до +0.5% при излучении в диапазоне 1.50-1.55 мкм [49]. Эти результаты согласуются с работой [50] для системы InGaAsP/InP, где было показано существование области оптимальных напряжений в структуре из нескольких квантовых ям с барьерами (там эта область простиралась от -0.17% до +0.14%) для увеличения интенсивности ФЛ на 2 порядка.

На рис. 6 представлены зависимости относительной интегральной интенсивности от длины волны излучения активной области при комнатной температуре для трех типов гетероструктур: 1 — КЯ InGaAsN/GaAs, 2 — КТ InAs/InGaAsN и 3 — НКСР (SCSL — Strain Compensated Super Lattice) InAs/GaAsN/InGaAsN. Интенсивность нормирована на значение, полученное от структуры с содержанием индия x = 33% и длиной волны излучения при комнатной температуре ~ 1.45 мкм (реперный (reference) образец). Образцы с КЯ и КТ без сверхрешеток демонстрируют хорошую интенсивность ФЛ вблизи 1.3 мкм, превышая в 3-4 раза реперную интенсивность. При этом полуширины линий ФЛ достигали ~ 40 мэВ при комнатной температуре (подробное исследование ФЛ было приведено в работе [48]). Однако при увеличении длины волны выше 1.4 мкм происходит падение интенсивности более чем на 2 порядка. Для образцов же с НКСР для длин волн 1.45-1.60 мкм не происходит падения интенсивности ниже чем  $\sim 0.7$ от реперного. Это указывает на перспективность таких структур и их дизайна для лазерных применений в области длин волн вблизи 1.55 мкм.

## 4. Заключение

В статье рассмотрены различные методы управления длиной волны излучения в ГС, полученных МПЭ, в спектральном диапазоне от  $\sim 1.3$  до  $\sim 1.76$  мкм при комнатной температуре: с помощью ГС с квантовыми ямами InGaAsN/GaAs, ГС с квантовыми точками InAs/InGaAs, осажденными в слой (In)GaAsN, и гетероструктур InAs/InGaAs/InGaAsN с компенсацией напряжений. Наиболее перспективным и показывающим возможности улучшения характеристик лазеров, излучающих на длине волны ~ 1.55 мкм, является предложенный способ с использованием напряженнокомпенсированных сверхрешеток GaAsN/InGaAsN. Показано, что использование таких НКСР и дополнительных вставок InAs в активную область улучшает излучательные свойства структур и позволяет продвинуться в сторону увеличения длин волн ФЛ до ~ 1.76 мкм наибольшей, по нашему мнению, из известных для азотсодержащих соединений на GaAs, без заметного ухудшения излучательной эффективности.

Работа выполнена в рамках проектов РФФИ № 06-02-16958-а, 07-02-01231-а, 07-02-05046-б, 05-02-17784-а и программы президента РАН "Квантовые наноструктуры".

## Список литературы

- [1] M. Weyers, M. Sato. Jpn. J. Appl. Phys., 31, L853 (1992).
- [2] B.V. Volovik, A.R. Kovsh, W. Passenberg, H. Kuenzel, N. Grote, N.A. Cherkashin, Yu.G. Musikhin, N.N. Ledentsov, D. Bimberg, V.M. Ustinov. Semicond. Sci. Technol. 16, 186 (2001).

- [3] В.А. Одноблюдов, А.Ю. Егоров, Н.В. Крыжановская, А.Г. Гладышев, В.В. Мамутин, А.Ф. Цацульников, В.М. Устинов. Письма ЖТФ, 28, 82 (2002).
- [4] I.A. Buyanova, W.M. Chen, B. Monemar. MRS Internet J. Nitride Semicond. Res., 6, 2 (2001).
- [5] S. Sakai, Y. Ueta, Y. Terauchi. Jpn. J. Appl. Phys., 32, 4413 (1993).
- [6] W. Shan, W. Walukiewicz, K.M. Yu, J.W. Ager III, E.E. Haller, J.F. Geisz, D.J. Friedman, J.M. Olson, S.R. Kurz, X.P. Xin, C.W. Tu. Phys. Rev. Lett., 82, 1221 (1999).
- [7] M.P.C.M. Krijn. Semicond. Sci. Technol., 6, 27 (1991).
- [8] A.Yu. Egorov, V.A. Odnobludov, V.V. Mamutin, A.E. Zhukov, A.F. Tsatsul'nikov, N.V. Kryzhanovskaya, V.M. Ustinov, Y.G. Hong, C.W. Tu. J. Cryst. Growth, 251, 417 (2003).
- [9] M.H. Ya, W.Z. Cheng, Y.F. Chen, T.Y. Lin. Appl. Phys. Lett., 81, 3386 (2002).
- [10] A. Lindsay, E.P. O'Reilly. Sol. St. Commum., 112, 443 (1999).
- [11] A.Yu. Egorov, V.K. Kalevich, M.M. Afanasiev, A.Yu. Shiryaev, V.M. Ustinov, M. Ikezawa, Y. Masumoto. J. Appl. Phys., 98, 013 539 (2005).
- [12] S. Sakai, Y. Ueta, Y. Terauchi. Jpn. J. Appl. Phys., 32, 4413 (1993).
- [13] L. Bellaiche, S.-H. Wei, A. Zunger. Phys. Rev. B, 54, 17568 (1996).
- [14] K. Uesugi, N. Morooka, I. Suemune. J. Cryst. Growth, 201– 202, 335 (1999).
- [15] J.W. Matthews, A.E. Blakeslee. J. Cryst. Growth, 27, 118 (1974).
- [16] Y. Zhang, A. Mascarenhas, H.P. Xin, C.W. Tu. Phys. Rev. B, 61 (7), 4433 (2000).
- [17] W. Li, M. Pessa, J. Likonen. Appl. Phys. Lett., 78, 2864 (2001).
- [18] S.Z. Wang, S.F. Yoon, W.J. Fan, W.K. Loke, T.K. Ng, S.Z. Wang, J. Appl. Phys., 96, 2010 (2004).
- [19] I.A. Buyanova, W.M. Chen, G. Pozina, J.P. Bergman, B. Monemar, H.P. Xin, C.W. Tu. Appl. Phys. Lett., 75, 501 (1999).
- M. Queslaty, M. Zouaghi, M.E. Pistol, L. Samuelson, H.G. Grimmeiss, M. Balkanski. Phys. Rev. B, 55, 8220 (1997).
- [21] H.P. Xin, C.W. Tu. Appl. Phys. Lett., 72, 2442 (1998).
- [22] T. Miyamoto, K. Takeuchi, T. Kageyama, F. Koyama, K. Iga. J. Cryst. Growth, **197**, 67 (1999).
- [23] M. Hetterich, M.D. Dawson, A.Yu. Egorov, D. Bernklau, H. Riechert. Appl. Phys. Lett., 76, 1030 (2000).
- [24] K. Hantke, J.D. Heber, C. Schlichenmaier, A. Thränhardt, T. Meier, B Kunert, K. Volz, W. Stolz, S.W. Koch, W.W. Rühle. Phys. Rev. B, **71**, 165 320 (2005).
- [25] R. Kudrawiec. J. Appl. Phys., 101, 023 522 (2007).
- [26] R. Kudrawiec, S.R. Bank, H.B. Yuen, H. Bae, M.A. Wistey, L.L. Goddard, J.S. Harris. Appl. Phys. Lett., 90, 131 905 (2007).
- [27] M. Kawagushi, E. Gouardes, D. Schlenker, T. Kondo, T. Miyamoto, F. Koyama, K. Iga. Electron. Lett., 36, 1776 (2000).
- [28] B. Borchert, A.Yu. Egorov, S. Illek, H. Riechert. IEEE Phot. Techn. Lett., 12, 597 (2000).
- [29] M. Kawagushi, T. Miyamoto, E. Gouardes, D. Schlenker, T. Kondo, F. Koyama, K. Iga. Jpn. J. Appl. Phys., 40, L744 (2001).
- [30] T. Takeuchi, Y.-L. Chang, M. Leary, A. Tandon, H.-C. Luan, D.P. Bour, S.W. Corzine, R. Twist, M.R. Tan. IEEE LEOS, post deadline session, 2001.
- [31] D.A. Livshits, A.Yu. Egorov, H. Riechert. Electron. Lett., 36, 1381 (2000).

- [32] K.-S. Kim, S.-J. Lim, K.-H. Kim, J.-R. Yoo, T. Kim, Y.-J. Park. IEEE Phot. Techn. Lett., 16, 1994 (2004).
- [33] J. Wei, F. Xia, C. Li, S.R. Forrest. IEEE Phot. Techn. Lett., 14, 597 (2002).
- [34] J.-Y. Yeh, N. Tansu, L.J. Mawst. Electron. Lett., 40, 739 (2004).
- [35] R. Averbeck, G. Jaschke, L. Geelhaar, H. Riechert. IEEE Sem. Laser Conf. (Sept. 21–25, 2004) Conference Digest, p. 69 (2004).
- [36] D. Gollub, S. Moses, A. Forchel. Electron. Lett., 40, 1181 (2004).
- [37] T. Kitatani, K. Nakahara, M. Kondow, K. Uomi, T. Tanaka. Jpn. J. Appl. Phys., **39** L86 (2000).
- [38] K. Mukai, N. Ohtsuka, M. Sugawara, S. Yamazaki. Jpn. J. Appl. Phys., 33, L1710 (1994).
- [39] A.R. Kovsh, J.S. Wang, L. Wei, R.S. Shiao, J.Y. Chi, B.V. Volovik, A.F. Tsatsulnikov, V.M. Ustinov, J. Vac. Sci. Technol. B, 20, 1158 (2002).
- [40] И.П. Сошников, Н.В. Крыжановская, Н.Н. Леденцов, А.Ю. Егоров, В.В. Мамутин, В.А. Одноблюдов, В.М. Устинов, О.М. Горбенко, Н. Kirmse, W. Neumann, D. Bimberg. ФТП. 38, 354 (2004).
- [41] В.А. Одноблюдов, А.Ю. Егоров, А.Р. Ковш, В.В. Мамутин, Е.В. Никитина, Ю.М. Шерняков, М.В. Максимов, В.М. Устинов. Письма ЖТФ, 29, 77 (2003).
- [42] В.М. Устинов, А.Ю. Егоров, А.Р. Ковш, В.А. Одноблюдов, В.В. Мамутин, Д.А. Лившиц, Н.В. Крыжановская, Е.С. Семенова, Е.В. Никитина, Ю.М. Шерняков, М.В. Максимов. Изв. АН. Сер. физ., 68, 15 (2004).
- [43] В.А. Одноблюдов, А.Ю. Егоров, А.Р. Ковш, В.В. Мамутин, Е.В. Никитина, Ю.М. Шерняков, М.В. Максимов, В.М. Устинов. Письма ЖФТ, 29 (10), 77 (2003).
- [44] H.Y. Liu, M. Hopkinson, P. Navaretti, M. Gutiereez, J.S. Ng, P.R. David. Appl. Phys. Lett., 83, 4951 (2003).
- [45] А.Ю. Егоров, В.В. Мамутин, В.М. Устинов. Патент РФ № 225760 (Заявка № 2004113171, приоритет от 28.04.2004).
- [46] A. Livshits, A.Yu. Egorov, H. Riechert. Electron. Lett., 36, 1381 (2000).
- [47] В.С. Михрин, Е.С. Семенова, Н.В. Крыжановская, А.Г. Гладышев, Ю.Г. Мусихин, А.П. Васильев, А.Ю. Егоров, А.Е. Жуков, В.М. Устинов. ФТП, 40, 347 (2006).
- [48] N.V. Kryzhanovskaya, A.Yu. Egorov, V.V. Mamutin, N.K. Polyakov, A.F. Tsatsul'nikov, Yu.G. Musikhin, A.R. Kovsh, N.N. Ledentsov, V.M. Ustinov, D. Bimberg. Semicond. Sc. Technol., 20, 961 (2005).
- [49] В.В. Мамутин, О.В. Бондаренко, А.П. Васильев, А.Г. Гладышев, А.Ю. Егоров, Н.В. Крыжановская, В.С. Михрин, В.М. Устинов. Письма ЖТФ, 33, 53 (2007).
- [50] M. Mitsuhara, M. Ogasavara, H. Sugiura. J. Cryst. Growth., 210, 463 (2000).

Редактор Т.А. Полянская

## Emission wavelength control methods in InAs/GaAsN/InGaAsN heterostructures on GaAs substrates

V.V. Mamutin, A.Yu. Egorov\*, N.V. Kryzhanovskaya\*, V.S. Mikhrin, A.M. Nadtochy, E.V. Pirogov\*

Ioffe Physicotechnical Institute, Russian Academy of Sciences, 194021 St. Petersburg, Russia \* St. Petersburg Physics and Technology Centre for Research and Education, Russia Academy of Sciences, 194021 St. Petersburg, Russia

**Abstract** We review the properties of the InGaAsN alloys, wavelength control methods in InAs/GaAsN/InGaAsN heterostructures containing InGaAsN quantum-size layers, grown by molecular beam epitaxy: (1) InGaAsN quantum wells deposited by conventional mode in GaAs matrix, (2) InAs quantum dots deposited in (In)GaAsN layer, (3) InAs/GaAsN/InGaAsN strain-compensated superlattices with quantum wells and quantum dots. The structures under investigations have demonstrated and controllable changed photoluminescence wavelength in a telecommunication wavelength range of  $1.3-1.76 \,\mu$ m at room temperature.